平成 29 年 11 月吉日

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団
三次元半導体研究センター

# 第 47 回ネプコンジャパン
# 「半導体・センサ パッケージング技術展」出展のご案内

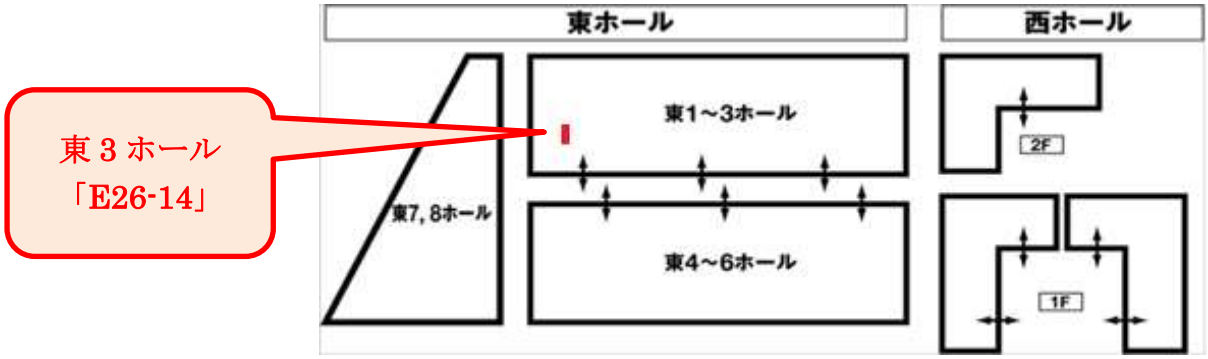
この度、当センターでは「第 47 回ネプコンジャパン（半導体・センサ パッケージング技術展）」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。当日は、センターの技術開発紹介を行うとともに、現在開発中のサンプル等も多数準備しておりますので皆様お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

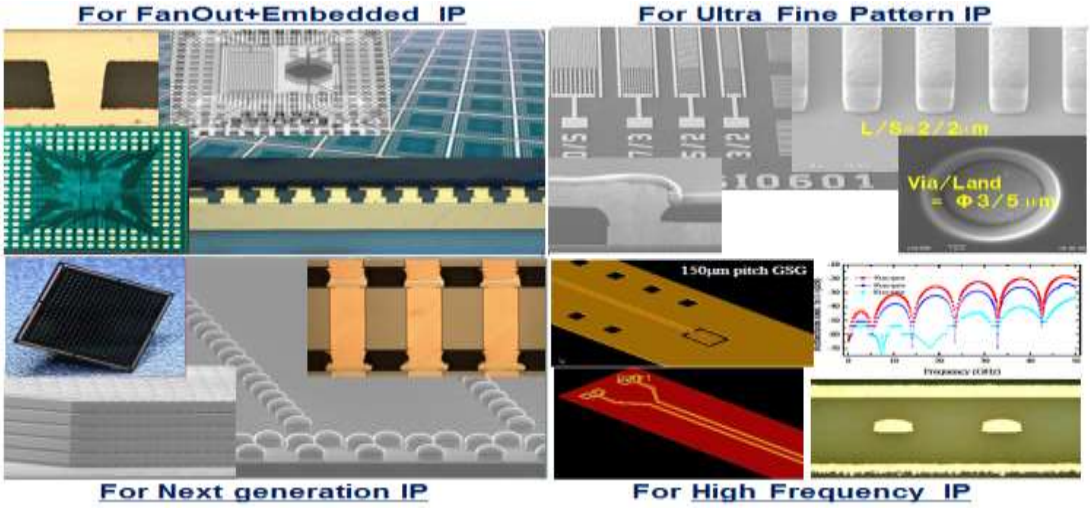
尚、展示会場への入場には、来場者 1 名につき 1 枚の招待券が必要ですので、追加をご希望される場合はご連絡下さい。スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

■開催期間：2018 年 1 月 17 日(水)～1 月 19 日(金)

■開催時間：10:00～18:00　※最終日は 17：00 まで

■開催場所：東京ビッグサイト　東 3 ホール「E26-14」




テクニカル WEB：http://www.itoshima-3dsemi.com

Facebook:『三次元半導体研究センター』にて展示サンプル等をご覧いただけます。

【問合せ先】　（公財）福岡県産業・科学技術振興財団　三次元半導体研究センター
〒819-1122 福岡県糸島市東 1963-4
電話：092-331-8550　FAX：092-331-8555
E-mail：3d-riyo@ist.or.jp